

SELF-DRIVING MODE

为新一代的移动出行带来变革！SEKISUI解决方案

Sekisui Mobility Solution



安全 (ADAS)



环境



设计/舒适

产品咨询

积水化学工业株式会社 高机能塑料事业领域 移动出行战略室

 sekisui-auto@sekisui.com



散热

1单剂热固化粘合性导热凝胶

开发中

安全 (ADAS)

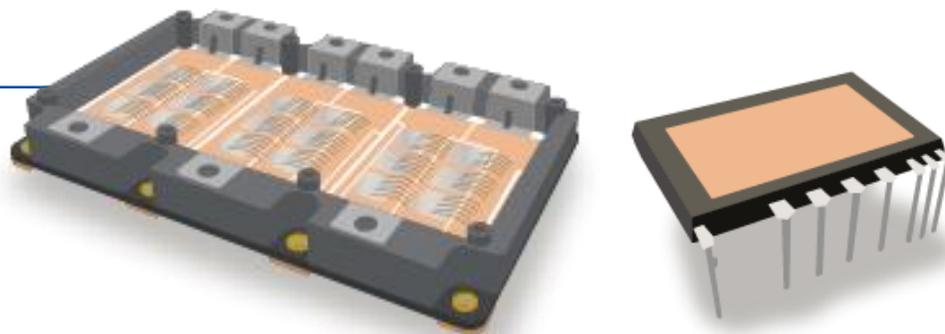
环境

设计/舒适

兼具散热性、粘合性和绝缘性的热固化导热凝胶

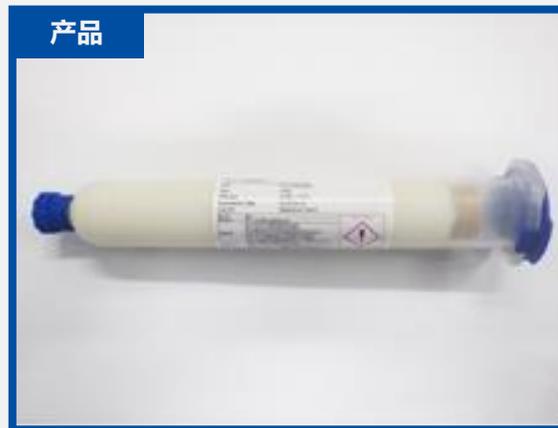


用途示例：功率半导体



※示例图

产品





散热

1单剂热固化粘合性导热凝胶

开发中

安全 (ADAS)

环境

设计/舒适

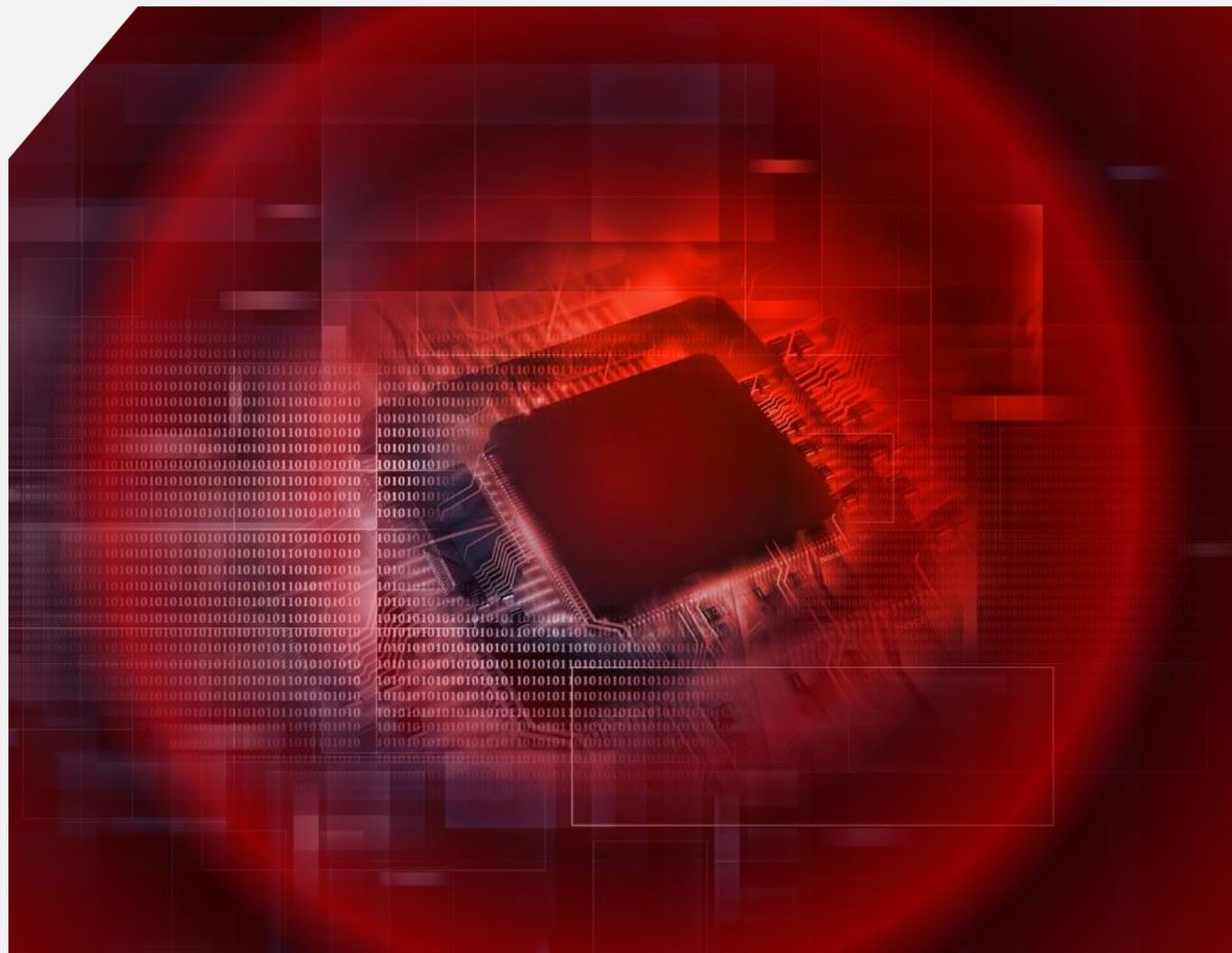


Challenge

实装工序中的高温对策

在半导体芯片的实装中，如果处于不能兼具散热性和粘合性的环境，有可能无法以理想的组合进行贴合。

耐热性高且兼具散热性的产品可以克服很多技术课题。





散热

1单剂热固化粘合性导热凝胶

开发中

安全 (ADAS)

环境

设计/舒适



Solution

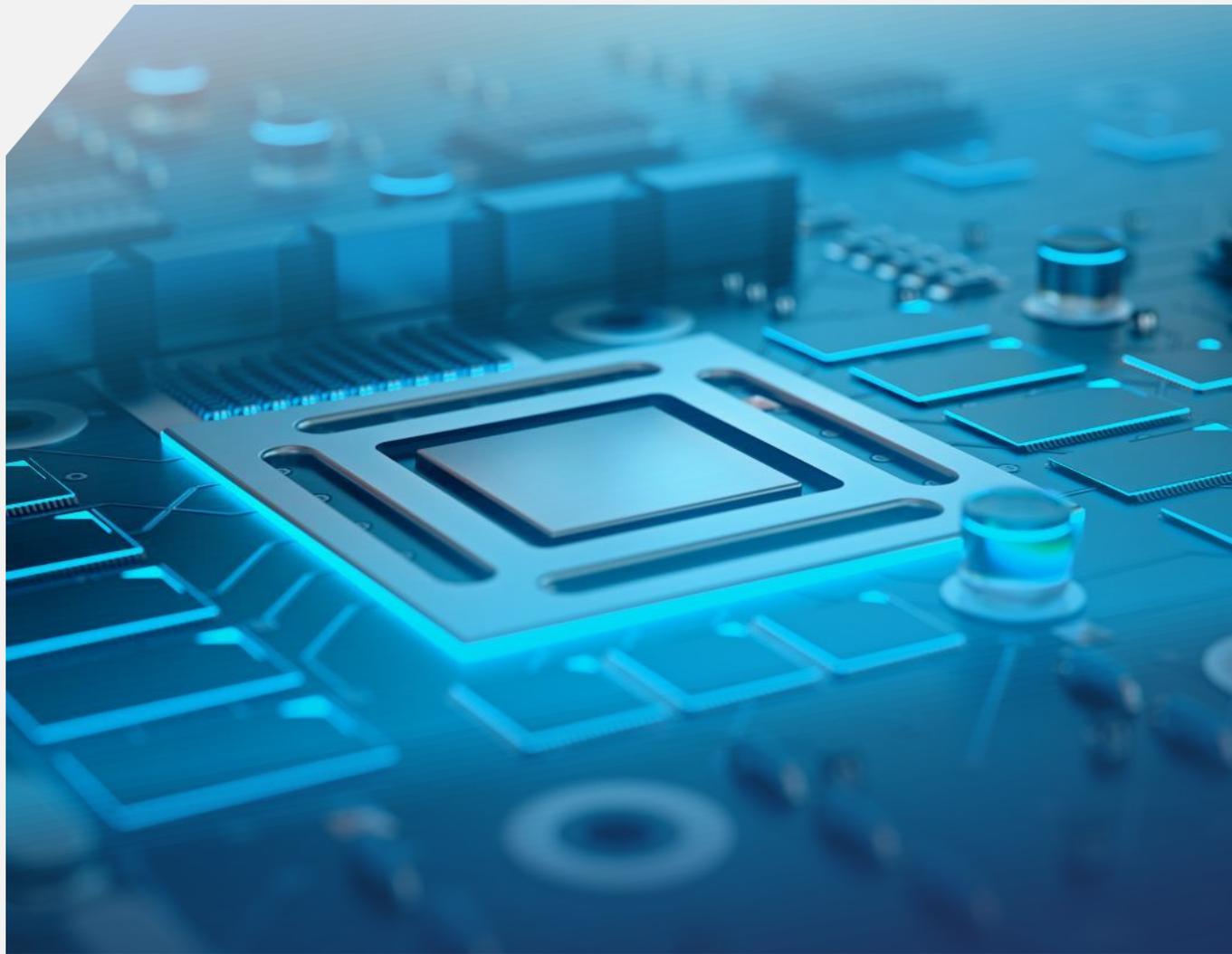
兼具高粘合性和柔韧性的导热凝胶

点涂用产品采用具有柔韧性的无硅材料涂在发热构件上，再通过烤箱固化，可无气泡成型。

而且，采用向空气中散热的方式，可以简单释放发热部件的热量。

特点：可适用于柔性基板，最低厚度（BLT）最小可支持 $20\mu\text{m}$ 。同时可实现超低热阻化，设计范围也较广。

另外，由于具有粘合性，所以也可以作为散热粘合剂使用。





散热

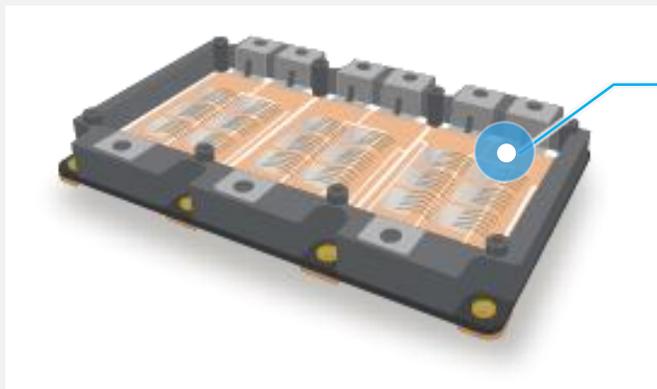
1单剂热固化粘合性导热凝胶

开发中

安全 (ADAS)

环境

设计/舒适



※示例图

技术概述

feature

01 高热传导率

热传导率: ~ 6.0 W/mK

对电子元器件和汽车相关部件的热分散作出贡献



feature

02 高粘性

粘合强度(Al/Al): 最大 8.0 MPa

实现散热性和粘合性的兼顾

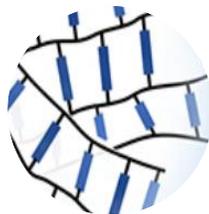


feature

03 低温固化型

热固化温度: 85°C ~

抑制周边零部件的热劣化

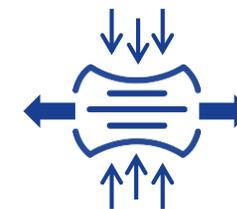


feature

04 低弹性模量

储存弹性模量: 300MPa

因低弹性, 所以操作性提高





技术数据

feature

01 高热传导率

产品	低温热固化产品	高散热产品	测量方法
热传导率	1.8 W/mK	6.0 W/mK	激光闪光

feature

02 高粘性

产品	低温热固化产品	高散热产品	测量方法
粘合强度 (Al/Al)	8.0 MPa	3.0 MPa	拉伸试验机

feature

03 低温固化型

产品	低温热固化产品	高散热产品	测量方法
固化条件	85°C, 2小时	150°C, 2小时	烤箱

feature

04 低弹性模量

产品	低温热固化产品	高散热产品	测量方法
储存弹性模量 @ 25°C	300 MPa	300 MPa	DMA